

八端口超高频模块SIM3300



IMPINJ Inside



特性

- 基于新一代Impinj E310阅读器芯片。
- 支持 EPC global UHF Class 1 Gen 2 (ISO 18000-6C)。
- 33dBm射频输出。
- 高性能防碰撞识别算法。
- 金属外壳. 有利于散热, 适用于工具柜、档案柜以及智能货架等场景。

物理特性	
尺寸	93.5mm x83.2mm x 8mm
重量	120g
射频连接器材质	黄铜镀金
PCB材质	FR4 镀金
屏蔽罩材质	铝合金
射频参数	
芯片	Impinj E310
空口协议	EPC global UHF Class 1 Gen 2 (ISO 18000-6C)
频率	北美: 902 ~ 928MHz (FCC (NA, SA))
	欧洲: 865 ~ 868MHz (ETSI)
	中国: 920 ~ 925MHz (CMIIT)
	全频段: 860 ~ 960MHz (OPEN')
灵敏度	-72dBm@10%BER
天线连接	8个SMA接口、信道隔离50dB
功率	5dBm ~ 33dBm (±1dB) 可调, 海外版最大功率为30dBm
工作模式	定频 / 跳频可选
RSSI	支持
温度检测	支持
天线检测	支持

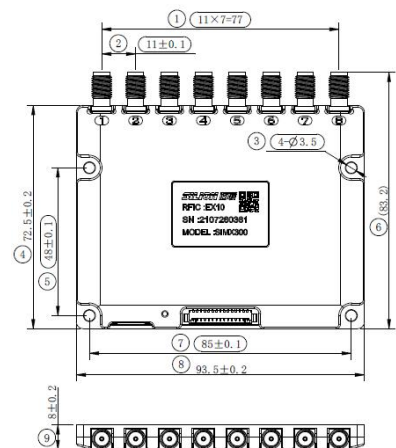
射频性能	
标签盘存峰值速度	>350 tags/s
识读距离	>13米 (使用8dBi铝板天线)
标签缓存	1000张标签@96 bit EPC
通信接口	
通信	UART 串口
	波特率 9600~921600bps @默认115200bps
GPIO	2路输入2路输出 (3.3V TTL)
通讯	15pin连接器 Uart3.3V (TTL)
供电	
电压	DC 5V±5%
最大功耗	8.25W (峰值), 1.65A@5V, 33dBm
待机功耗	0.75W
环境参数	
工作温度	-25°C ~ +65°C
储存温度	-40°C ~ +85°C
湿度	5 ~ 95% 非冷凝 (+25°C)
散热方式	外置散热片空气冷却
API接口	
支持 API	C, C#/.NET, Java

*规格如有更改, 恕不另行通知。

线束连接器定义

引脚	定义	引脚	定义
1	GND	9	RXD (DATA INPUT, TTL level)
2	GND	10	TXD (DATA OUTPUT, TTL level)
3	VCC +5V ±0.25V	11	NC
4	VCC +5V ±0.25V	12	NC
5	GPIO1 (OUT1)	13	NC
6	GPIO2 (OUT2)	14	SHUTDOWN(Low level enable, High level power Off, high level should be greater than VCC-0.3V)
7	GPIO3 (IN1)		
8	GPIO3 (IN2)	15	nRST (Reset, low-power calming position)

尺寸图



芯联创展电子技术股份有限公司 芯联创展上海办事处

北京总部
地址: 中国 北京 昌平区 102200
龙域北街3号金域国际中心A座5层
Tel: (010) 6215-3842

上海办公室
地址: 中国 上海 嘉定区 201801
云谷路599弄6号TEEC上海中心大厦311
Tel: 159-0190-6309

深圳市芯联创展电子技术有限公司

深圳办公室
地址: 中国 深圳 南山区 518055
珠光路52号珠光创新科技园1栋3层
Tel: (0755) 2661-7878

SILION 芯联

www.silion.com.cn

E-mail: sales@silion.com.cn